

平成24年9月27日

「香川発大学・高専連携シーズ発表会2012」について

香川大学、徳島文理大学及び香川高等専門学校は、それぞれが地域の皆様のお役に立ち、地域の活性化を実現できるよう、取り組んでおります。昨年に引き続き、互いに連携して研究シーズを発表します。地域の皆様に活用していただける研究シーズが見いだせると思いますので、ぜひご来場ください。

また、当日は知的財産や技術等に関する相談も受け付けますので、お気軽にお声かけ下さい。

1. 日時：平成24年10月10日（水）13：30～16：45

2. 場所：サンメッセ香川2階中会議室（香川県高松市林町2217-1）

3. 研究シーズ発表スケジュール

13：30 開会挨拶

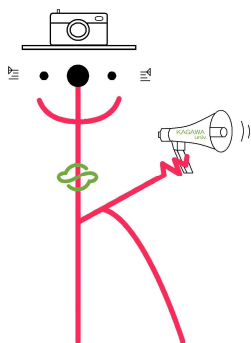
13：40～16：40 研究シーズ発表

- ・「セラミックス，セラミックス－金属接合部材の強度評価の研究」平田英之（香川大学）
- ・「高磁場・高騒音下でも明瞭な骨伝導光・音声マイクロフォンの開発」中山仁史（香川高専）
- ・「CMOS IC実装時の完全断線-半断線故障の検出方法」高木正夫（香川高専）
- ・「逆磁歪効果を利用した高接触面圧測定センサ開発の試み」大上祐司（香川大学）
- ・「酸化物エレクトロニクスの新展開－蓄電フィルム形成基盤技術－」梶山博司（徳島文理大学）
- ・「モノのインターネット(Internet of Things)に向けた標準化動向と大規模データ収集への応用」妹尾尚一郎（徳島文理大学）
- ・「成形金属中空球による高衝撃吸収性超軽量ポラス金属の開発」吉村英徳（香川大学）

16：40～16：45 閉会挨拶

4. 参加対象者：香川大学学生・教職員、地域自治体、地域企業関係者、一般来場者 など

5. 参加費：無料



➤ 問い合わせ先

〒761-0396 高松市林町2217-20

香川大学 社会連携・知的財産センター（倉増敬三郎）

TEL：087-864-2524 FAX：087-864-2549

E-mail：ccip@eng.kagawa-u.ac.jp